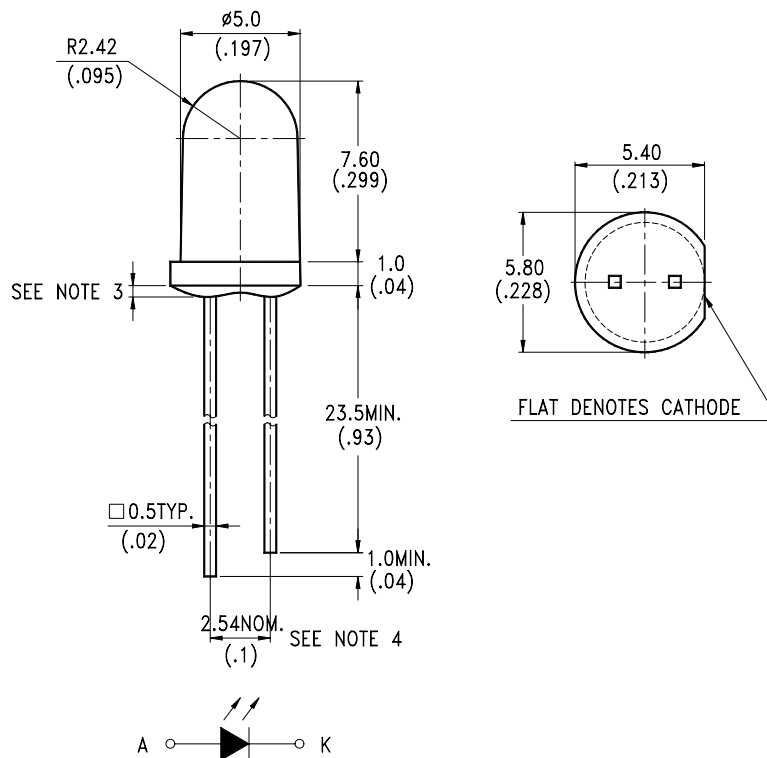


FEATURES

- * SPECIAL FOR HIGH CURRENT AND LOW FORWARD VOLTAGE
- * HIGH POWER
- * AVAILABLE FOR PULSE OPERATING
- * WIDE VIEWING ANGLE

PACKAGE DIMENSIONS**NOTES:**

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ± 0.25 mm(.010") unless otherwise noted.
3. Protruded resin under flange is 1.5mm(.059") max.
4. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
5. Specifications are subject to change without notice.



LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION.

Property of Lite-On Only

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT TA=25

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation	150	mW
Peak Forward Current (300pps, 10 μ s pulse)	2	A
Continuous Forward Current	100	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature Range	-40 to + 85	
Storage Temperature Range	-55 to + 100	
Lead Soldering Temperature [1.6mm(.063") From Body]	260 for 5 Seconds	

ELECTRICAL OPTICAL CHARACTERISTICS AT TA=25

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION	BIN GRADE
Aperture Radiant Incidence	Ee	1.12			mW/cm ²	I _F = 20mA	BIN D
Radiant Intensity	I _E	8.42			mW/sr	I _F = 20mA	BIN D
Peak Emission Wavelength	P		940		nm	I _F = 20mA	
Spectral Line Half-Width			50		nm	I _F = 20mA	
Forward Voltage	V _F		1.25	1.6	V	I _F = 50mA	
Forward Voltage	V _F		1.85	2.3	V	I _F = 500mA	
Reverse Current	I _R			100	μ A	V _R = 5V	
Viewing Angle (See FIG.6)	2 1/2		50		deg.		

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES

(25 Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

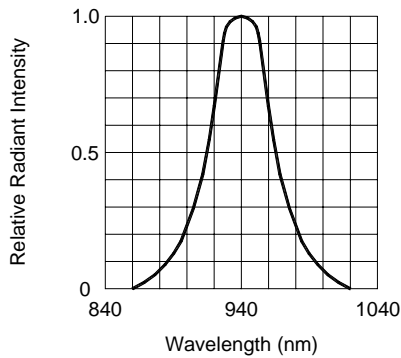


FIG.1 SPECTRAL DISTRIBUTION

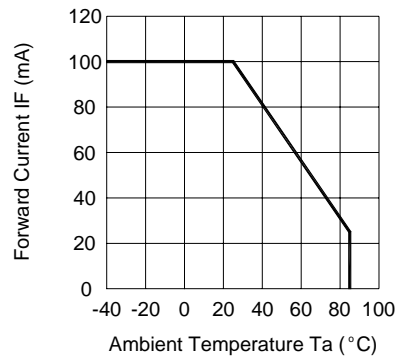


FIG.2 FORWARD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE

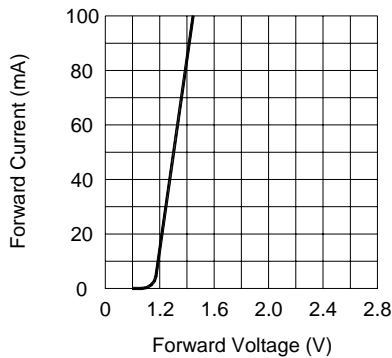


FIG.3 FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE

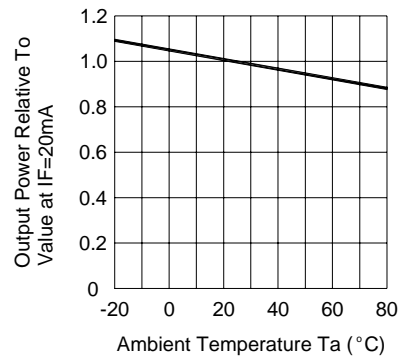


FIG.4 RELATIVE RADIANT INTENSITY VS. AMBIENT TEMPERATURE

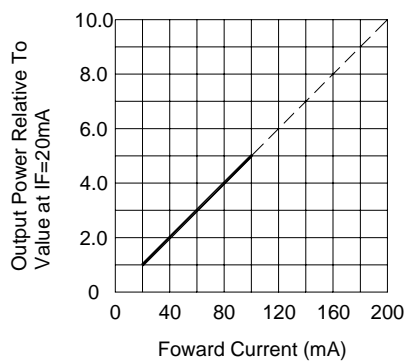


FIG.5 RELATIVE RADIANT INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

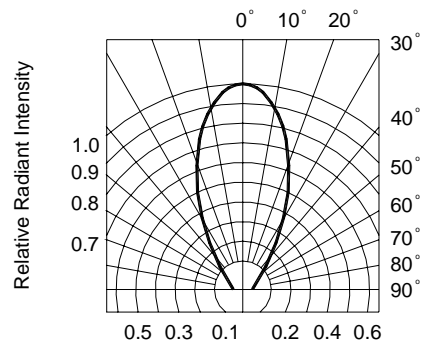


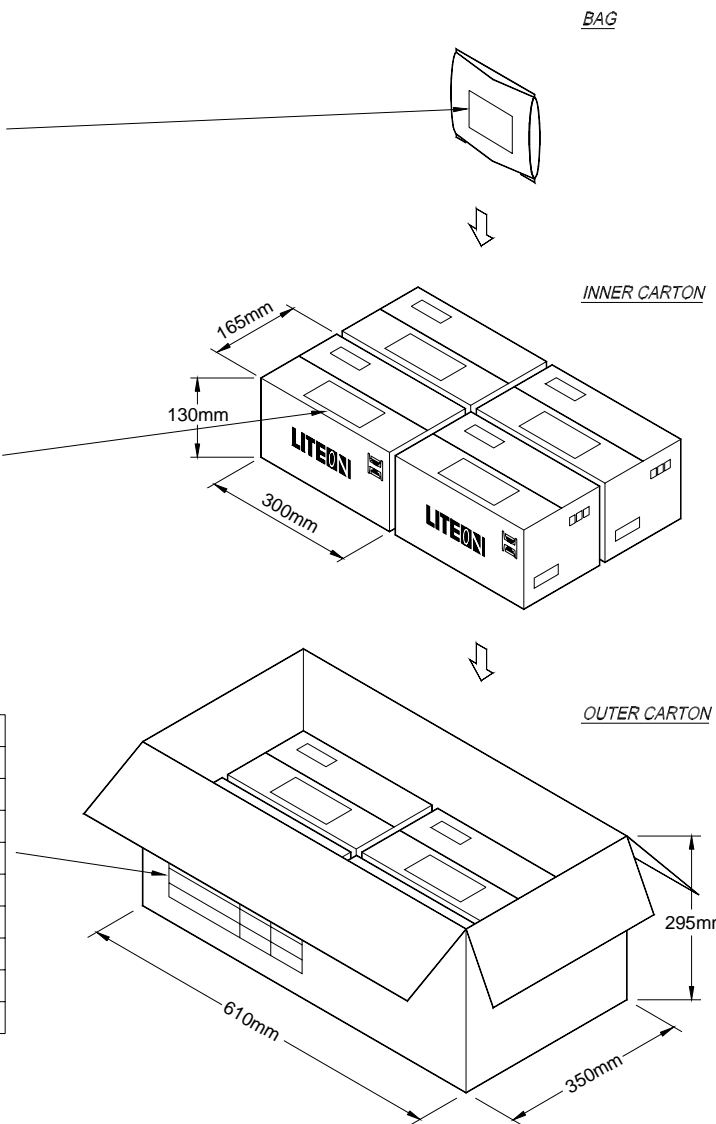
FIG.6 RADIATION DIAGRAM

PACKING

LITEON	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP.	
CUSTOMER:	_____
DEVICE TYPE:	LTE-3271B
BIN GRADE:	_____
LOT NO.:	_____
Q'TY:	_____
RMK:	_____

CUSTOMER	:	_____
CUSTOMER P/N:	:	_____
DEVICE TYPE	:	_____
BIN	:	LTE-3271B
COLOR RANK	:	_____
QUANTITY	:	_____
Q. C STAMP	:	_____

DIVICE NO.	BIN	QUANTITY
LTE-3271B		
Q.C STAMP		



Bag volume (pcs / Bag)	Inner carton volume (Bag / carton)	Outer carton volume (Box / Carton)	Total volume (pcs/outer carton)
1000	8	8	64000

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9